

Rheological Characterization of Solder Pastes, Conductive Adhesives and Other Printing Materials Used in Electronic Industry

김승록*

MCIK

(srkim@mcik.co.kr*)

첨단 IT 제품의 수출 호황과 더불어 친환경 에너지 자원 확보를 위한 전세계적인 추세에 발 맞추어 Solder pastes 및 각종 전자 부품 생산에 사용되는 다양한 전도성 페이스트 개발 및 관련 가공 공정 및 품질 관리 (QC) 기술의 개발이 최근 국내에서 크게 주목을 받고 있다. 고형분이 Paste rheology 에 끼치는 영향의 요소별 분석 및 Vehicle binder 의 Rheology 에 영향을 끼치는 주요 인자들이 함께 소개 되며 관련된 주요한 시험 방법이 논의된다. 벤치 마킹 제품에 대한 Rheological characterization 을 위한 전제 조건 및 관련 유변학적인 도구 및 방법이 제시 된다. 연속적으로 쉽게 Dispense 하여 우수한 종횡비 (High aspect ratios) 를 형성하는 Paste 와 관련된 Rheological characterization 분야에 대한 시험 방법 소개 및 관련 측정 기술 개발을 위한 방향이 제시 되어 질 것이다.